

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【公表番号】特表2010-524236(P2010-524236A)

【公表日】平成22年7月15日(2010.7.15)

【年通号数】公開・登録公報2010-028

【出願番号】特願2010-502175(P2010-502175)

【国際特許分類】

<i>H 01 L</i>	23/373	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	125/02	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	125/08	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	125/10	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	125/20	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	125/26	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	125/04	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	105/38	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	105/18	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	107/50	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	137/04	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	149/20	(2006.01)
<i>C 10 M</i>	169/00	(2006.01)
<i>C 09 K</i>	5/08	(2006.01)
<i>H 01 L</i>	23/36	(2006.01)
<i>H 05 K</i>	7/20	(2006.01)
<i>C 08 L</i>	101/00	(2006.01)
<i>C 08 K</i>	3/00	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	10/02	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	10/04	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	10/06	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	10/12	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	10/16	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	20/00	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	20/06	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	40/00	(2006.01)
<i>C 10 N</i>	50/10	(2006.01)

【F I】

<i>H 01 L</i>	23/36	M
<i>C 10 M</i>	125/02	
<i>C 10 M</i>	125/08	
<i>C 10 M</i>	125/10	
<i>C 10 M</i>	125/20	
<i>C 10 M</i>	125/26	
<i>C 10 M</i>	125/04	
<i>C 10 M</i>	105/38	
<i>C 10 M</i>	105/18	
<i>C 10 M</i>	107/50	
<i>C 10 M</i>	137/04	
<i>C 10 M</i>	149/20	
<i>C 10 M</i>	169/00	

C 0 9 K	5/00	E
H 0 1 L	23/36	D
H 0 5 K	7/20	F
H 0 5 K	7/20	Q
C 0 8 L	101/00	
C 0 8 K	3/00	
C 1 0 N	10:02	
C 1 0 N	10:04	
C 1 0 N	10:06	
C 1 0 N	10:12	
C 1 0 N	10:16	
C 1 0 N	20:00	A
C 1 0 N	20:06	
C 1 0 N	40:00	Z
C 1 0 N	50:10	

【手続補正書】**【提出日】**平成23年2月28日(2011.2.28)**【手続補正1】****【補正対象書類名】**特許請求の範囲**【補正対象項目名】**全文**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【特許請求の範囲】****【請求項1】**

第1剥離表面を含む第1剥離ライナーと、
第2剥離表面を含む第2剥離ライナーと、

前記第1剥離表面と前記第2剥離表面との間の熱伝導性グリースの層と、を含む物品であって、前記熱伝導性グリースは、少なくとも3つの分布の熱伝導性粒子の混合物を含み、前記少なくとも3つの分布の熱伝導性粒子のそれぞれが、他の分布から少なくとも5倍異なる平均(D_{50})粒径を有する、物品。

【請求項2】

前記熱伝導性グリースが、

0～約49.5重量%のキャリアオイルと、
0.5～25重量%の少なくとも1つの分散剤と、

少なくとも49.5重量%の熱伝導性粒子と、を含む、請求項1に記載の物品。

【請求項3】

第1剥離表面を含む第1剥離ライナーと、
第2剥離表面を含む第2剥離ライナーと、

前記第1剥離表面と前記第2剥離表面との間の熱伝導性グリースの層と、を含む物品であって、前記熱伝導性グリースが、実質的にPCMを含まず、前記第1表面及び前記第2表面の少なくとも一方が、フルオロカーボン材料、シリコーン材料、フルオロ-シリコーン材料、アクリル、又はこれらの組み合わせを含む、物品。

【請求項4】

電子部品、放熱部材、及び熱分配部材の少なくとも1つを含む基材と、

該基材上の熱伝導性グリースの層であって、前記熱伝導性グリースは、少なくとも3つの分布の熱伝導性粒子の混合物を含み、前記少なくとも3つの分布の熱伝導性粒子のそれぞれが、他の分布から少なくとも5倍異なる平均(D_{50})粒径を有する、熱伝導性グリースの層と、

前記熱伝導性グリースの前記層上の剥離表面を有する剥離ライナーと、を含む、電子ア

センブリ。

【請求項 5】

前記熱伝導性グリースが、実質的にPCMを含まない、請求項4に記載の電子アセンブリ。

【請求項 6】

前記剥離表面が、フルオロカーボン材料、シリコーン材料、フルオロ-シリコーン材料、アクリル、又はこれらの組み合わせを含む、請求項4に記載の電子アセンブリ。

【請求項 7】

第1剥離表面を含む第1剥離ライナーと、

第2剥離表面を含む第2剥離ライナーと、

前記第1剥離表面と前記第2剥離表面との間の熱伝導性グリースの層とを含む、積層体を提供する工程であって、前記熱伝導性グリースが、少なくとも3つの分布の熱伝導性粒子の混合物を含み、前記少なくとも3つの分布の熱伝導性粒子のそれぞれが、他の分布から少なくとも5倍異なる平均(D_{50})粒径を有する、工程と、

前記第1剥離ライナーを取り除き、前記熱伝導性グリースの前記層を少なくとも部分的に露出させる工程と、

前記熱伝導性グリースの前記層を、電子部品、放熱部材、又は熱分配部材の1つを含む基材に塗布する工程と、を含む、電子デバイスを作製するための方法。

【請求項 8】

前記熱伝導性グリースが、実質的にPCMを含まない、請求項7に記載の方法。